

半導体製造装置部品関連向けダイヤ焼結体工具 とダイヤ砥石のご案内です！！



ダイヤ焼結体
切削工具

OSGが硬脆材向け微細精密加工用工具を
シリーズ化！



- ・ 半導体前工程製造装置の消耗品
- ・ シリコン、石英、セラミック、SiC
- ・ 超硬製(ピン)パンチ
- ・ 研削から切削へ
- ・ 小径多刃ねじれPCDで差別化



6C x OSG

PCDエンドミル

PCD-MRM 12アイテム

外径xRx有効長			
Φ0.5xR0.05x0.5	Φ1.0xR0.05x1.0	Φ2.0xR0.1x1.5	Φ3.0xR0.1x1.5
Φ0.5xR0.05x1.0	Φ1.0xR0.05x3.0	Φ2.0xR0.1x3.0	Φ3.0xR0.1x3.0
Φ0.5xR0.05x1.5	Φ1.0xR0.05x5.0	Φ2.0xR0.1x5.0	Φ3.0xR0.1x5.0



PCD面取りカッタ

PCD-MCM 3アイテム



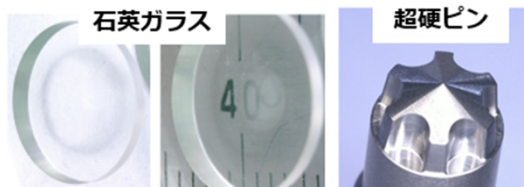
外径x面取り角度
Φ1x90°
Φ2x90°
Φ3x90°

PCDスレッドミル (ねじ切りカッタ)

PCD-MCM 3アイテム



ねじサイズ
M1.2-P0.25
M2.0-P0.40
M2.5-P0.45



ダイヤ砥石



超砥粒ホイールメーカー



豊田バンモックス株式会社

JTEKT GROUP

生産性 × **加工品質** の両立を実現！！

ウエハ研削加工

被削材例:SiC/Si/LN
/LT/GaN ウエハ



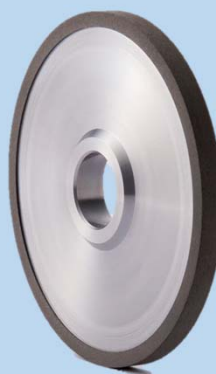
被削材:6 inch SiCウエハ

精度

表面粗さ	Ra 0.8 nm
TTV	1 μm

ビトリファイドダイヤモンドホイール
“nanoVi”

半導体治具研削加工



被削材:アルミナ
静電チャック



被削材:SiC円盤

レジンダイヤモンドホイール
“テラメイト”



<https://www.tvmk.co.jp/>

—お知らせ—

ユアサ商事(株)バブパワーが
2021年(第64回)日刊工業新聞十大新製品賞モノづくり賞を受賞しました！



詳しくはこちら